

CIU98_D 系列芯片数据手册

- ARM 处理器
- 78KB FLASH
- 支持 DES/AES/ECC/SHA-n 算法
- 支持国产 SM2/3/4/SM9 算法
- 硬件真随机数发生器
- 多种接口（SPI、7816 串口、I2C、1WI、GPIO）
- 多种可设置的低功耗模式
- 多种防 SPA/DPA/DFA 攻击的安全属性设置

[2020-04]

处理器特性

- 高安全性 32 位 CPU
 - ARM SC000 RISC 处理器
 - Thumb/Thumb2 指令集
 - 支持 Privilege 和 Unprivileged 两种运行状态
 - 具有多种防 SPA 等攻击安全属性
 - 低功耗设计
- 时钟系统
 - 系统时钟可设置为 48MHz 的分频
 - PKE 时钟最高为 48MHz 的分频
- 向量中断控制器
 - 16 个中断源
 - 优先级可配置
- 低功耗模式
 - 正常工作模式
 - CPU Hold 模式
 - Standby 模式
 - StopClk 模式
 - Power down 模式
- 复位系统
 - 硬复位
 - 软复位

存储器

- RAM
 - 系统 RAM: 9.5KB
- FLASH
 - User Flash 区: 78KB
 - 支持 10 万次擦写, 10 年数据保持时间

接口

- ISO7816 串口
 - 符合“ISO7816-3”规范要求
 - 符合“ETSI TS 102 221”规范要求
 - 支持 T=0/1 协议
 - 支持 8~2048 分频比
 - 奇偶校验方式可配置
 - 支持 7816 接口时钟频率 1~10MHz
- SPI
 - 符合 SPI 接口规范
 - 支持 Master 和 Slave 可软件配置
 - 支持 MSB 或 LSB 传输

- 支持中断和查询模式
- 作为 Master 接口
 - 支持 Standard 模式
 - 支持 Mode0、1、2、3
 - 支持输出时钟频率可配置
 - 最大支持 24MHz@5V,30pF 负载
- 作为 Slave 接口
 - 最大支持 10MHz@5V,30pF 负载
 - 支持 Mode0、1、2、3
 - 支持 Standard 模式
- GPIO
 - 5 个
 - 可根据需要配置成输入或输出

电气特性

- 工作电流：
 - 动态电流典型值：10mA@25° C
 - standby 电流<200uA @25° C
 - 低功耗 Power down 电流：<1uA@25° C
- 工作电压：1.62V~5.5V
- 工作温度：-25°C~85°C 和-40°C~85°C
- ESD： 6KV (HBM) ;CDM \geq 500V

安全特性

- 采用 32 位 ARM 安全处理器内核
- 支持 Unprivilege 和 Privilege 两种模式
- 支持存储器访问权限保护机制
- 安全传感器
- 复位毛刺过滤/时钟毛刺过滤
- 有源屏蔽层
- DES/TDES 算法防 SPA/DPA 设计
- SM4 算法防 SPA/DPA 设计
- AES 算法防 SPA/DPA/DFA 设计
- SM9 算法防 SPA/DPA/DFA 设计
- SM2 算法防 SPA/DPA/DFA 设计
- ECC 算法防 SPA/DPA/DFA 设计
- 存储器地址加扰，数据加密，总线数据极性控制
- 达到 AIS20[2011]PTG.2 标准的真随机数发生器
- 安全防护措施专用随机数
- 自检功能

CIU98_D 芯片硬件结构

芯片基于 ARM RISC 处理器和 AMBA 总线结构设计，主要面向基于密码算法的认证芯片，支持丰富的密码算法和接口类型。

芯片系统结构如下图所示：

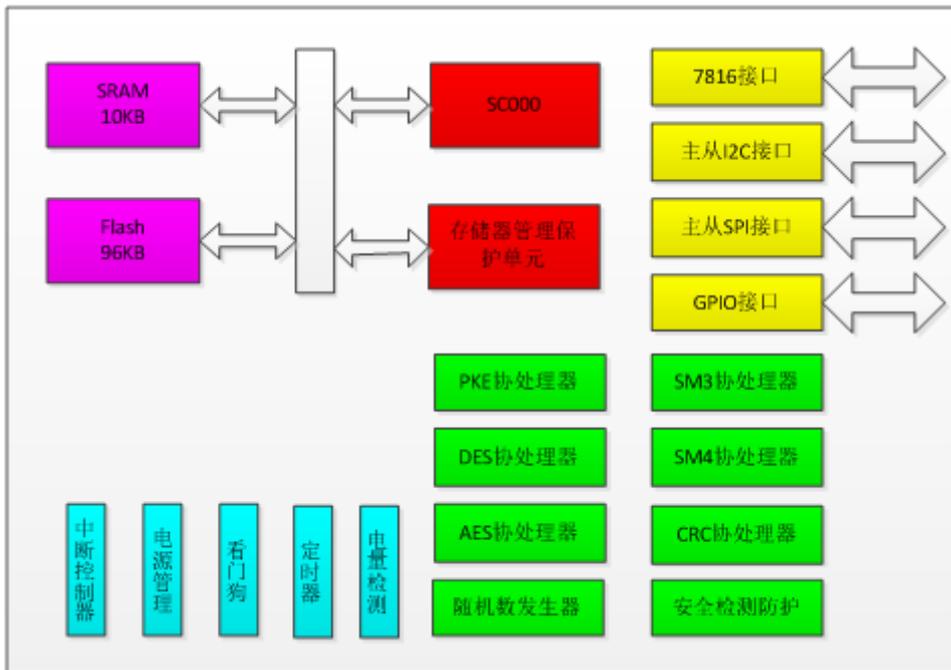


图 1 芯片系统结构框图

CIU98_D 芯片电气特性

表 1 绝对最大额定值

符号	说明	条件	限值 (注 1)		单位	备注
			Min	Max		
T _{STG}	存储温度		-40	125	°C	注 2
T _J	工作结温		-40	105	°C	
V _{ESD-CB}	ESD 电压	HBM		6	KV	注 3
		MM		400	V	
		CDM		500	V	
V _{CC}	电源电压		-0.3	6.5	V	
V _{IO/rst/cik}	相对地的输入电压		-0.3	V _{CC} +0.3	V	

注 2: 短期加载条件

注 3: 根据 MIL-STD 883(HBM);JS-002-2014(CDM)的测试方法

CIU98_D 开发环境

芯片的开发环境为业界主流的 KEIL UVISION3 MDK 应用软件，配合华大 CIU98 硬件开发工具使用，可支持 C 语言编程、汇编语言编程和两者的混合编程方式。

为方便用户开发，配套提供大量与开发相关的底层函数库和例程供使用。结合芯片的编程指南、DEMO 例程和函数库相关文件，用户可以最大程度地节省开发时间，提高开发效率。

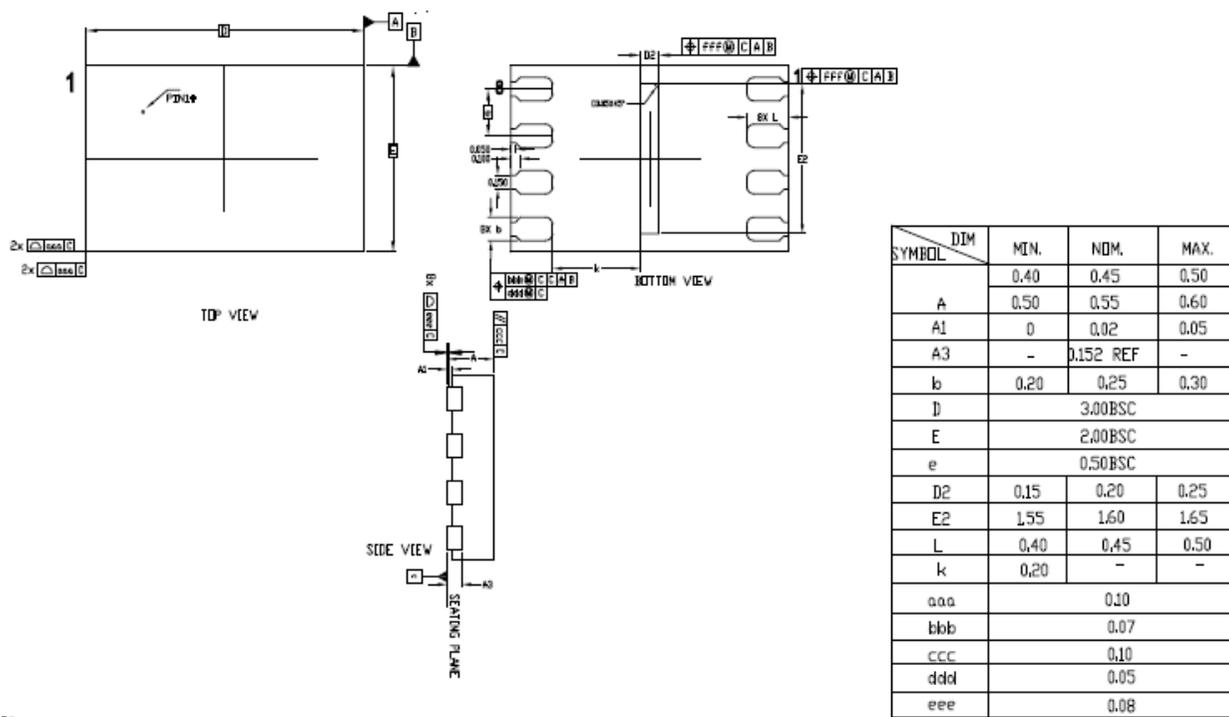
CIU98_D 封装特性

封装基本信息

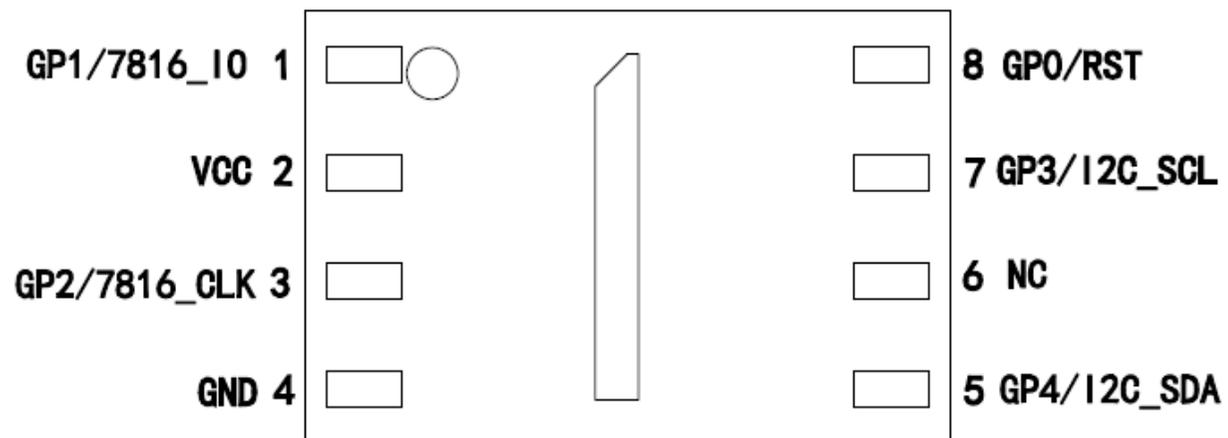
基本信息	
封装形式	DFN8
封装尺寸	2x3x0.55-0.5(长 x 宽 x 厚度-管脚间距、单位: mm)
是否符合 RoHS	Yes

可靠性等级	MSL3
包装方式	Reel (卷带)

封装外形尺寸图



封装管脚示意图

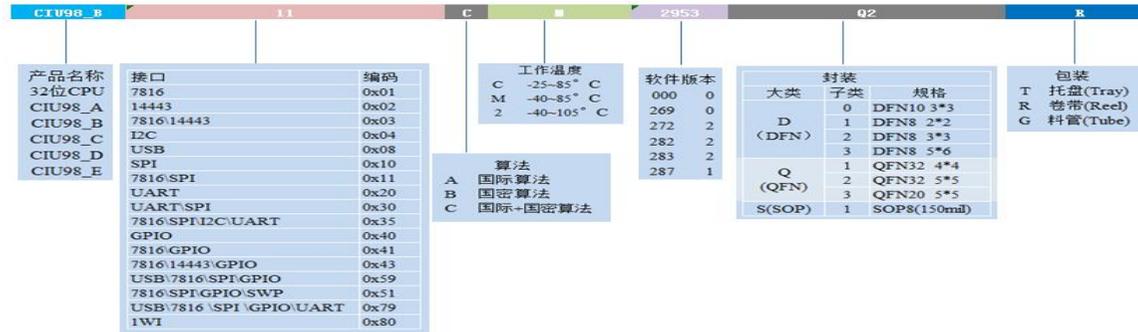


封装管脚描述

封装管脚编号	管脚名称	管脚描述
1	GP1	通用双向 GPIO1/7816_IO 复用可配、默认 7816_IO（内部缺省上拉）
2	VCC	系统电源，1.62~5.5V
3	GP2	通用双向 GPIO2/7816_CLK 复用可配、默认 7816_CLK（内部缺省上拉，

封装管脚编号	管脚名称	管脚描述
		建议软件断开 IO 内部上拉)
4	GND	系统地
5	GP4	通用双向 GPIO4/I2C_SDA 复用可配、默认 I2C_SDA (内部缺省上拉/推挽模式, 建议软件断开 IO 内部上拉/配置为开漏模式)
6	NC	-
7	GP3	通用双向 GPIO3/I2C_SCL 复用可配、默认 I2C_SCL (内部缺省上拉/推挽模式, 建议软件断开 IO 内部上拉/配置为开漏模式)
8	GP0	通用双向 GPIO0/RST 复用可配、默认 RST (内部缺省上拉)

CIU98_D 产品物料信息



产品名称	产品物料编码	容量	RAM	接口	算法	工作电压	工作温度	软件版本	封装	包装	产品特性	应用领域
CIU98_D	CIU98_D05AM0000W0x	78KB	9.5KB	7816,I2C	ECC,SHA256,SHA1,AES,DES	1.62~5.5V	-40~85°C	0000	wafer	Tray	安全SE	智能门锁、智能家居、智能表计等
CIU98_D	CIU98_D05AC0000D4T	78KB	9.5KB	7816,I2C	ECC,SHA256,SHA1,AES,DES	1.62~5.5V	-25~85°C	0000	DFN8 (2*3)	Tray	安全SE	智能门锁、智能家居等
CIU98_D	CIU98_D05AM0000D4T	78KB	9.5KB	7816,I2C	ECC,SHA256,SHA1,AES,DES	1.62~5.5V	-40~85°C	0000	DFN8 (2*3)	Tray	安全SE	智能门锁、智能家居等
CIU98_D	CIU98_D05DM0000D4T	78KB	9.5KB	7816,I2C	SM2,SM3,SM4,DES	1.62~5.5V	-40~85°C	0000	DFN8 (2*3)	Tray	安全SE	智能门锁、智能家居等
CIU98_D	CIU98_D05EM0000D4T	78KB	9.5KB	7816,I2C	SM9,SM3,SM4,DES	1.62~5.5V	-40~85°C	0000	DFN8 (2*3)	Tray	安全SE	智能门锁、智能家居等
CIU98_D	CIU98_D04AM2813D4T	8KB	9.5KB	I2C	ECC,SHA256,AES,DES	1.62~5.5V	-40~85°C	2813	DFN8 (2*3)	Tray	安全SE,满足小米安全规范	智能门锁、智能家居等
CIU98_D	CIU98_D05AM2782D4T	8KB	9.5KB	7816,I2C	ECC,SHA256,AES,DES	1.62~5.5V	-40~85°C	2782	DFN8 (2*3)	Tray	安全SE,满足阿里规范	智能门锁、智能家居等
CIU98_D	CIU98_D10DM2792D4T	8KB	9.5KB	SPI	SM2,SM3,SM4,DES	1.62~5.5V	-40~85°C	2792	DFN8 (2*3)	Tray	安全SE,满足阿里规范	智能门锁、智能家居等
CIU98_D	CIU98_D05DM2792D4T	8KB	9.5KB	7816,I2C	SM2,SM3,SM4,DES	1.62~5.5V	-40~85°C	2792	DFN8 (2*3)	Tray	安全SE,满足阿里规范	智能门锁、智能家居等
CIU98_D	CIU98_D05EM2802D4T	8KB	9.5KB	7816,I2C	SM9,SM3,SM4,DES	1.62~5.5V	-40~85°C	2802	DFN8 (2*3)	Tray	安全SE,满足阿里规范	智能门锁、智能家居等